

【11】證書號數：M581177

【45】公告日：中華民國 108 (2019) 年 07 月 21 日

【51】Int. Cl. : *F21S4/20 (2016.01)* *F21V23/00 (2015.01)*  
*F21V29/87 (2015.01)*

新型

全 2 頁

---

【54】名稱：LED 燈泡

【21】申請案號：108202936

【22】申請日：中華民國 108 (2019) 年 03 月 12 日

【72】新型創作人：王興燁 (TW)

【71】申請人：鴻鎵科技股份有限公司

臺中市西屯區逢福里河南路二段 262 號 7 樓之 10

【74】代理人：田國健；林湧群；曹銘煌

#### 【57】申請專利範圍

1. 一種 LED 燈泡，包含有：

一燈殼、一燈頭、至少一設於該燈殼內可全面性有效發光之 LED 發光體及一設於該燈頭內具有氮化鎗電晶體之驅動電路板，其中，該燈殼以可透光之材質製成之中空球體，該燈頭設於該燈殼一端，且該燈頭具有一端部及一螺紋段以形成供電之正負極，該 LED 發光體將數個沒有反光板之 LED 芯片呈鋸齒狀分布排列後，再將各 LED 芯片間以導線連接，再將一正極導電線及一負極導電線與頭尾之 LED 芯片連接，之後再以導熱絕緣膠體封裝，該驅動電路板電性連接該 LED 發光體之正極導電線及負極導電線，且該驅動電路板之電源正負極輸入部再以導線連接至該燈頭的螺紋段及該端部，利用燈頭連接電源後經該驅動電路板驅動該 LED 發光體發光。

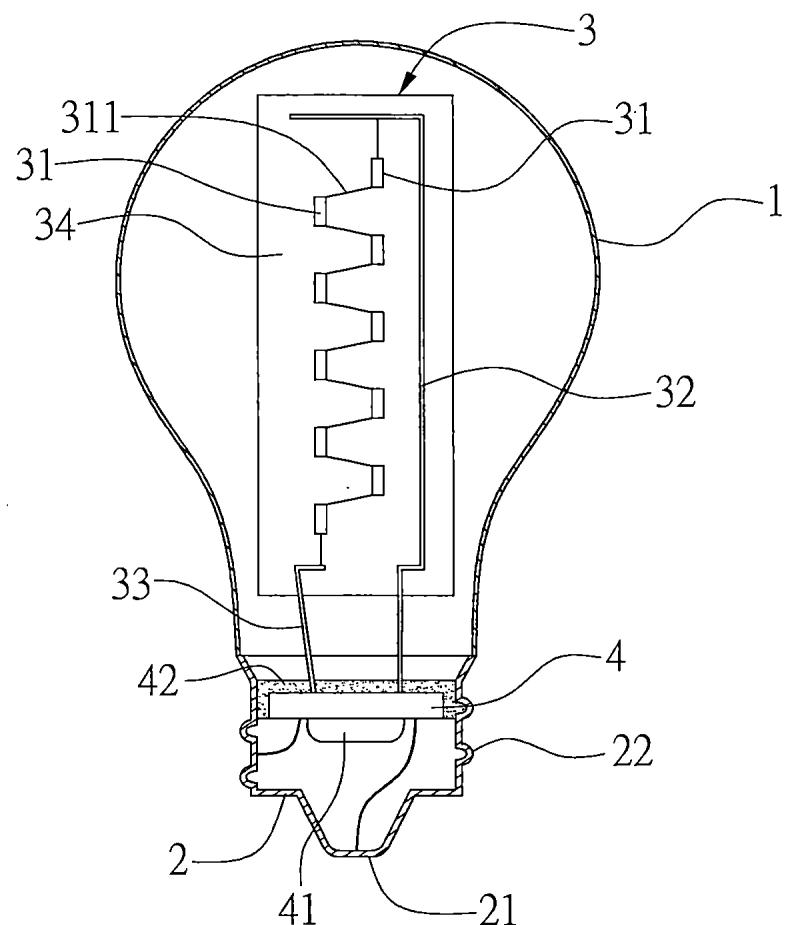
2. 如請求項 1 所述之 LED 燈泡，其中，該驅動電路板對應該 LED 發光體之一側塗佈一層散熱膠的隔熱層，該隔熱層周緣會填滿該驅動電路板與該燈頭內壁間之空隙。

圖式簡單說明

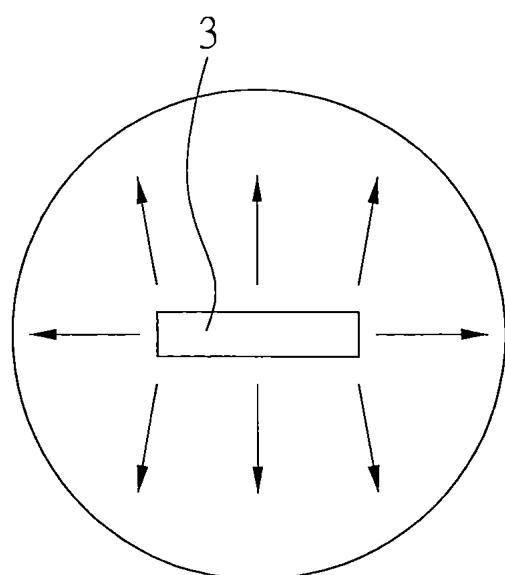
第 1 圖為本創作之結構示意圖。

第 2 圖為本創作之全面性發光示意圖。

(2)



第 1 圖



第 2 圖